

公益社団法人精密工学会 プラナリゼーションCMP とその応用技術専門委員会
第163回研究会【国際学会 ICPT2017 から厳選した発表特集】開催ご案内

このたび、プラナリゼーションCMP 専門委員会では、下記のとおり【国際学会 ICPT2017 から選抜した発表特集】と題して第163回研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。なお、午前中、同会場にて【3D 勉強会】を開催いたしますので、ご参加いただければ幸いです。また、研究会終了後、情報交換会を行いますので、是非ご参加下さい。



日時：2018年2月13日（火）12:40～19:00

（総会・研究会・・・12:40～17:10 B2F「クラルテ」、情報交換会・・・17:15～19:00 8F「スイセン」）

開催場所：プラザエフ（JR 四ッ谷駅麴町口から徒歩1分）

東京都千代田区六番町15（TEL：03-3265-8111）

内容：

12:40～12:42 開会挨拶

檜山委員長

12:42～12:55 総会

12:55～17:00 話題提供

「テーマ：国際学会 ICPT2017 から厳選した発表特集」

12:55～13:00 趣旨説明

檜山委員長・黒河副委員長・近藤副委員長

1) 13:00～13:35 (35分) <招待講演> ウェーハ接合におけるCMP技術の重要性

株式会社 D-process 迫田 仁 氏

<概要> 現在、イメージセンサ、光デバイス、パワーデバイスなどで使われている接合技術。その中でも表面粗さが接合品質に与える影響が大きい直接接合においては、CMP技術がその品質を左右する。そこで、ウェーハ接合におけるCMP技術の重要性について発表する。

2) 13:35～14:05 (30分) ウェット雰囲気における微粒子の微小付着力測定技術

株式会社 荏原製作所 嶋 昇平 氏

<概要> CMP 後洗浄での汚染除去力の定量的評価を目的として、実プロセスと同じウェット雰囲気、砥粒に見立てた微粒子を除去するのに必要な力を AFM を用いて測定した。ナニュートン (nN) レベルの微小な付着力測定に際しての注意点なども含めて講演する。

3) 14:05～14:35 (30分) 分光エリプソメトリによる sub 100-nm 粒子の検出と粒子密度評価

山梨大学 近藤 英一 氏

<概要> 洗浄技術を開発する上で、粒子の付着と除去に関する簡便な評価の技術が必要となる。ウェーハに 50-300 nm の粒子を付着させ、分光エリプソメトリを用いて相対濃度を評価した。

4) 14:35～15:05 (30分) Study on the Grit Angle of Single Diamond Dressing on CMP Pads

Nano Art Project, 九州工業大学名誉教授 木村 景一 氏

<概要> CMP 用パッドのドレッシングメカニズム解明のため、2種類の単粒ダイヤモンド工具によりパッド表面の引掻き試験を行った。工具はすくい角 0°、先端角 90°のV形状工具、および頂角 120°の円錐状工具であり、各々について切りくず生成、引掻き現象、引掻き力等について検討した。

.....
15:05～15:15 休憩 (10分)
.....

5) 15:15～15:45 (30分) コロイダルセリアを用いた石英ガラス基板の高効率・高品位 CMP

ソルベイ・スペシャルケム・ジャパン 株式会社 須田 栄作 氏

<概要> シリコン酸化膜のCMPにおいて、スクラッチなどの欠陥を回避しながら高効率研磨を行うことは重要である。本検討ではコロイダルセリアに KOH 水溶液を混合し、石英ガラス研磨を試みた。研磨速度や AFM による表面粗さの測定結果を報告する。

6) 15:45～16:10 (25分) ICPT2017 における注目発表

株式会社 荏原製作所 檜山 浩國 氏

<概要> 昨年ベルギーのルーベン市で開催された CMP の国際学会 ICPT2017 の概要と注目発表を紹介する。

7) 16:10 ~ 17:00 (50分) <特別講演> 史上空前の半導体ブームはIoTがキーワード

株式会社 産業タイムズ社 泉谷 渉 氏

<概要> 今や40兆円を大きく超えてきた半導体産業は、ここ数年のうちに100兆円の巨大市場に一大飛躍しようとしている。これを支えるのは5G高速通信であり、次世代コネクテッドカー、データセンター、AI、ロボットなどの新アプリである。今回はIoTをキーワードに設備投資ラッシュを迎えた半導体産業および装置動向を最新取材でレポートする。

17:00 ~ 17:05 その他 (事務連絡)

17:05 ~ 17:10 閉会の挨拶

17:15 ~ 19:00 情報交換会

参加費：

1. 企業会員：無料 (年会費 100,000 円)
2. 官学会員：無料 (年会費無料・要登録)
3. 非会員：30,000 円 (今回の研究会のみの参加費)
※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。
※参加費にはプロシーディング代、懇親会費が含まれます。
※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。
※準備の都合上、懇親会ご参加有無について必ず記入をお願いいたします。

2018年2月13日(火)開催 第163回研究会 参加申込書

会員 / 一般 (いずれかにチェックしてください)

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会		技術交流会
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		

※新ホームページからオンライン申し込みできます。

<http://www.planarization-cmp.org/registration>

問合せ先：「プラナリゼーションCMP 専門委員会」事務局 (三上)
TEL : 03-5117-2225, FAX : 03-5117-2223, E-mail : mikami@global-net.co.jp